

第11世代Core™、PCI-Express Gen 4.0に対応し ハイエンドGPU×最大2基搭載可能



画像処理・マシンビジョン向け タワー型PC
IPC-R590TIC-T



- 第11世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載可能
- インテル® Z590チップセット装備
- 最大128GBメモリー (DDR4-3200)搭載可能
- PCI-Express Gen 4.0対応
- NVIDIA RTX / GeForce RTX 30を2基搭載可能
- Thunderbolt 4×2ポート、
USB3.2 (Gen2, TypeA)×2ポートを装備
- マルチギガビットイーサネット(2.5GbE)を装備
- 最大1500W出力可能な日本製電源ユニットを装備

☑ ハイエンド向けインテル® Z590チップセットを採用

製品品質と生産効率を向上させるためには、撮像する画像データを精細で高解像度化する必要があります。一方、産業用コンピューターに求められる処理能力は低遅延であり、更なる高速性が求められています。Z590チップセットは第11世代インテル® Core™ プロセッサ、PCI-Express Gen 4.0、DDR4-3200といった次世代規格の対応により、高速処理を実現します。

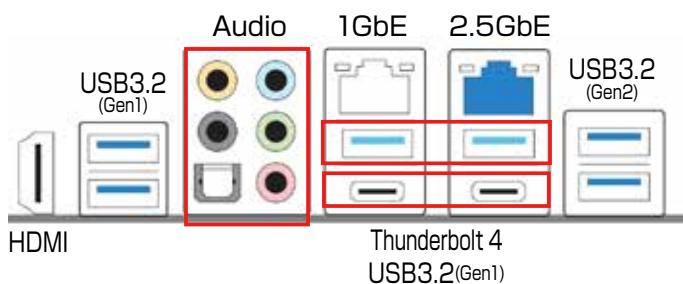
☑ PCI-Express Gen 4.0のハイエンドGPUを最大2基搭載可能

NVIDIA® AmpereアーキテクチャーのNVIDIA RTXシリーズ / GeForce RTX 30シリーズを最大2基まで搭載可能。GPUメモリーによる高速処理が求められるマシンビジョン、ディープラーニング、エッジコンピューティング分野などに適しています。 ※第10世代インテル® Core™ プロセッサ選択時はGen 3.0になります処理を実現します。

■製品仕様

モデル	IPC-R590TIC-T	
プロセッサ	種類	第11世代インテル® Core™ プロセッサ / 第10世代インテル® Core™ プロセッサ ※TDP最大125Wまでのインテル® Core™i9 / Core™i7 / Core™i5 / Core™i3 / Pentium® / Celeron® プロセッサをサポート
	搭載数	1
チップセット	インテル® Z590チップセット	
メモリー	規格	DDR4-3200 nECC ※第11世代インテル Core™(i9/i7/i5) プロセッサは、最大3200までのDDR4に対応します。Core™ i3、Pentium®およびCeleron®は、最大2666までのDDR4に対応します。 ※10世代インテル Core™(i9/i7)は、最大2933までのDDR4に対応します。Core™ (i5/i3)、Pentium®およびCeleron®は、最大2666までのDDR4に対応します。
	容量	標準32GB (16GB×2) ※最大128GB
	スロット数	4
ストレージ	5インチベイ	4
	3.5インチベイ	1
	3.5インチシャドーベイ	5(空き4) ※標準搭載しているストレージのベイは3.5インチ→2.5インチ変換マウント(2台用)を使用して2.5インチストレージを搭載
GPU	NVIDIA RTXシリーズ / GeForce RTX 30シリーズ ※最大2基まで搭載可能	
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス	
I/O	HDMI	1
	USB	前面 2 (USB3.2 Gen1, TypeA) / 背面 2 (USB4.0, Thunderbolt 4, TypeC)、2 (USB3.2 Gen2, TypeA)、4 (USB3.2 Gen1, TypeA)
	LAN	1 (2.5GbE)、1 (1GbE)
	Audio	背面 6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out)
拡張スロット	Slot7 : None Slot6 : PCI-Express x16 (Gen 4.0、x16/x8シグナル、CPU側) ※第10世代インテル® Core™ プロセッサ選択時はGen 3.0になります Slot5 : None Slot4 : None Slot3 : PCI-Express x16 (Gen 4.0、NA/x8シグナル、CPU側) ※第10世代インテル® Core™ プロセッサ選択時はGen 3.0になります Slot2 : PCI-Express x1 (Gen 3.0、PCH側) Slot1 : PCI-Express x16 (Gen 3.0、x4シグナル、PCH側)	
外形寸法	タワー W200mm × D560mm × H430mm (突起物等を除く)	
重量	TBC	
電源	ニプロン電源 1200W (連続最大容量) / 1500W (ピーク容量)	
利用環境	入力電圧	AC90V~240V
	温度	10℃~35℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)

■I/Oポート



■拡張スロット



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

2021年6月現在の内容です。